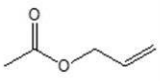
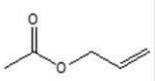
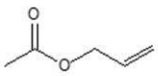
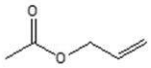
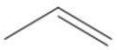
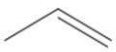
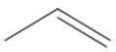
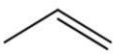
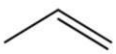
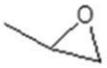
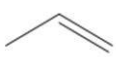
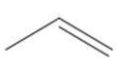
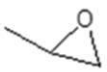
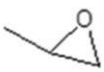
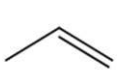
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年3月3日(2016.3.3)

【公開番号】特開2015-129308(P2015-129308A)
【公開日】平成27年7月16日(2015.7.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-045
【出願番号】特願2015-69430(P2015-69430)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｌ　23/20　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/3492　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　3/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｊ　7/00　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　33/60　(2010.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　23/20
Ｃ０８Ｋ　5/3492
Ｃ０８Ｋ　3/00
Ｃ０８Ｊ　7/00　３０５
Ｃ０８Ｊ　7/00　ＣＥＳ
Ｈ０１Ｌ　33/00　４３２

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月15日(2016.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリメチルペンテンと架橋処理剤とを含み、
前記架橋処理剤が、ジアリルモノグリシジルイソシアヌル酸又はモノアリルジグリシジルイソシアヌレートである電子線硬化性樹脂組成物。
【請求項２】
ポリメチルペンテン１００質量部に対して前記架橋処理剤が０．１～１５質量部配合されてなる請求項１に記載の電子線硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
白色顔料を含む請求項１又は２に記載の電子線硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
前記白色顔料以外の無機粒子を含む請求項３に記載の電子線硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
前記白色顔料以外の無機粒子が球状溶融シリカ粒子及び／又は異形断面ガラス繊維である請求項４に記載の電子線硬化性樹脂組成物。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の電子線硬化性樹脂組成物の硬化物からなるリフレクター用樹脂フレーム。
【請求項７】
厚さが０．１～３．０ｍｍである請求項６に記載のリフレクター用樹脂フレーム。
【請求項８】

請求項１～５のいずれか１項に記載の電子線硬化性樹脂組成物の硬化物からなるリフレクター。
【請求項９】
光半導体素子と、該光半導体素子の周りに設けられ、該光半導体素子からの光を所定方向に反射させるリフレクターとを基板上に有し、
前記リフレクターの光反射面の少なくとも一部が請求項１～５のいずれか１項に記載の電子線硬化性樹脂組成物の硬化物からなる半導体発光装置。
【請求項１０】
請求項１～５のいずれか１項に記載の電子線硬化性樹脂組成物に対し、射出温度２００～４００℃、金型温度２０～１００℃で射出成形する射出成形工程と、射出成形工程の前又は後に、電子線照射処理を施す電子線照射工程を含む成形体の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
【表１】
表 1-1

	架橋処理剤 又は架橋助剤 （分子量）	構造			
		式	R^1	R^2	R^3
架橋 処理剤 1	ダップモノマー (246.3)	式 (2)			−
架橋 処理剤 2	ダップ 100 モノマー (246.3)	式 (2)		−	
架橋 処理剤 3	TAIC (249.3)	式 (1)			
架橋 処理剤 4	MeDAIC (223.2)	式 (1)	CH_3		
架橋 処理剤 5	DA-MGIC (265.3)	式 (1)			
架橋 処理剤 6	MA-DGIC (281.3)	式 (1)			
架橋 処理剤 7	TMAIC (291.4)	式 (1)			